

Title (en)  
DEVICE ARRANGEMENT

Title (de)  
GERÄTEANORDNUNG

Title (fr)  
AGENCEMENT D'APPAREILS

Publication  
**EP 3435488 A1 20190130 (DE)**

Application  
**EP 18185926 A 20180727**

Priority  
DE 102017117179 A 20170728

Abstract (en)  
[origin: CN209150334U] An electronic device arrangement (1) is described, comprising: a first device part (2) having a first printed circuit board (9); and a second device part (3) having a second printed circuit board (6). The first and second device parts are designed to overlap one another in a planar manner. The first and second circuit boards form two layers spaced apart from each other when the first and second device parts lie flat on top of each other, and at least one wall of the device housing (5, 8) of one of the two device parts lies between the first and second circuit boards. The first and second circuit boards have contact areas. According to the utility model, a third contact element is provided, which can be electrically conductively connected indirectly to the contact region of the first circuit board via the first contact element and can be electrically conductively connected directly or indirectly to the contact region of the second circuit board via the second contact element, said third contact element passing through the at least one wall.

Abstract (de)  
Eine Geräteanordnung (1) mit einem ersten Geräteteil (2), das eine erste Leiterplatte (9) hat, und einem zweiten Geräteteil (3), das eine zweite Leiterplatte (6) hat, wird beschrieben. Das erste und zweite Geräteteil (2, 3) sind zur flächigen Anordnung aufeinander ausgebildet. Die erste und zweite Leiterplatte (9, 6) bilden zwei voneinander beabstandete Lagen, wenn das erste und zweite Geräteteil (2, 3) flächig aufeinander angeordnet sind, und sich zumindest eine Wandung eines Gerätegehäuses (5, 8) eines der beiden Geräteteile (2, 3) zwischen der ersten und zweiten Leiterplatte (9, 6) befindet. Die erste und zweite Leiterplatte (9, 6) haben Kontaktbereiche. Es ist ein drittes Kontaktelement vorgesehen, das mit einem Kontaktbereich der ersten Leiterplatte (9) mittelbar über ein erstes Kontaktelement (11, 29) und mit einem Kontaktbereich der zweiten Leiterplatte (6) unmittelbar oder mittelbar über ein zweites Kontaktelement (14) elektrisch leitend verbindbar ist, wobei das dritte Kontaktelement (15, 28) die zumindest eine Wandung durchgreift.

IPC 8 full level  
**H01R 12/71** (2011.01); **H01R 12/52** (2011.01); **H01R 12/58** (2011.01)

CPC (source: EP)  
**H01R 12/523** (2013.01); **H01R 12/718** (2013.01); **H01R 12/58** (2013.01); **H01R 13/2421** (2013.01); **H01R 33/965** (2013.01)

Citation (search report)  
• [XY] US 9016902 B1 20150428 - LIN CHIA-YEN [CN], et al  
• [X] CN 102366677 A 20120307 - DONGGUAN HEJIA PLASTIC PRODUCTS CO LTD  
• [X] EP 2818219 A1 20141231 - LIN CHIA-YEN [CN]  
• [Y] US 9673544 B1 20170606 - CHEN BINGSHUI [CN]

Designated contracting state (EPC)  
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)  
BA ME

DOCDB simple family (publication)  
**EP 3435488 A1 20190130**; **EP 3435488 B1 20210901**; CN 209150334 U 20190723; DE 102017117179 A1 20190131;  
DE 102017117179 B4 20200326

DOCDB simple family (application)  
**EP 18185926 A 20180727**; CN 201821184601 U 20180725; DE 102017117179 A 20170728